

## **博敏电子股份有限公司**

### **为控股子公司银行授信提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏博敏电子有限公司（以下简称“江苏博敏”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1,000 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 22,767.76 万元（不含本次）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

为满足博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司（含全资或控股子公司）2019 年度拟向银行申请不超过 21 亿元人民币的综合授信额度。公司对控股子公司江苏博敏的担保总额不超过人民币 2.5 亿元，公司接受江苏博敏的担保总额不超过 4.6 亿元，上述额度可视需要进行互相调配。该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、2018 年年度股东大会审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）于 2019 年 3 月 28 日披露的公司《关于 2019 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告（临 2019-026）》和 2019 年 4 月 18 日披露的公司《2018 年年度股东大会决议公告（2019-037）》。

在上述授权范围内，江苏博敏因日常经营发展需要，向江苏常熟农村商业银行股份有限公司盐城分行申请授信额度为人民币 1,000 万元，期限为一年。由公司为江苏博敏上述授信提供连带责任保证担保。

## 二、被担保人基本情况

被担保单位名称：江苏博敏电子有限公司

注册地点：盐城市大丰区开发区永圣路9号

法定代表人：徐缓

经营范围：高端印制电路板（高多层 PCB 板、任意阶 HDI、刚柔 FPC）、新型电子元器件、传感器、物联网 RFID 天线、SIP 一体化集成器件、半导体器件研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

江苏博敏为公司控股子公司，公司持有其 91.67% 股权，公司全资子公司深圳市博敏电子有限公司持有其 8.33% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，江苏博敏资产总额为 84,698.95 万元，负债总额为 62,574.74 万元，其中银行贷款总额为 13,975 万元、流动负债总额为 54,586.57 万元，净资产为 22,124.21 万元，2018 年实现营业收入为 43,123.63 万元，净利润为-1,395.91 万元。（以上数据经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，江苏博敏资产总额为 93,640.34 万元，负债总额为 70,450.99 万元，其中银行贷款总额为 15,970 万元、流动负债总额为 61,029.61 万元，净资产为 23,189.35 万元，2019 年 1-9 月营业收入为 42,540.06 万元，净利润为 1,065.14 万元。（以上数据未经审计）

## 三、担保协议的主要内容

担保金额：人民币 1,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

担保范围：主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师代理费、差旅费）。

## 四、董事会意见

董事会认为：此次担保是为满足江苏博敏在经营过程中的资金需要，被担保方为公司控股子公司，江苏博敏经营状况稳定，资信情况良好，担保风险可控，

不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意此次担保事项。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 255,437.02 万元（除上市公司与合并报表范围内的子公司相互为各自提供的担保外，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的 112.35%；公司对控股子公司提供的担保总额为 133,335 万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.64%。（未经审计、不含本次担保）

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2020 年 1 月 7 日